



特性

- 》优异的热传导率
- 》良好的绝缘性能
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》极致柔软，低压缩应力有效保护敏感元件

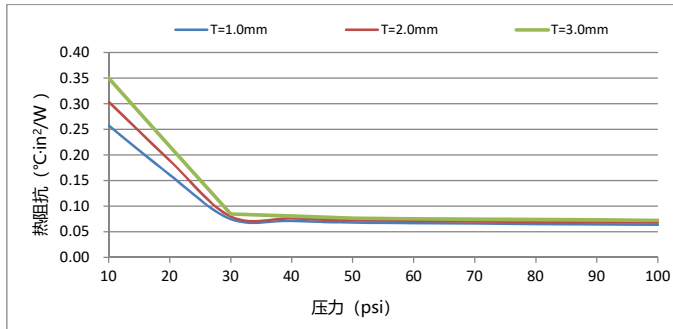
应用

- 》AI服务器
- 》半导体封装
- 》低空飞行器
- 》光通信产品
- 》5G基站

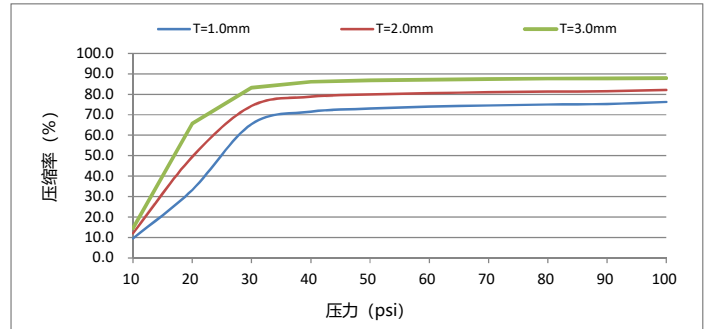
TIF®700RES 一款专为应对高级别散热挑战和极端机械应力敏感环境而设计的导热垫片。它将卓越导热能力与近乎流体的极致柔软度集于一身，确保在超低的安装压力下，也能实现对接触界面的完美填充，彻底消除空气热阻，为最精密、最高热流密度的电子元器件提供卓越的散热解决方案和物理保护。

TIF® 700RES 系列特性表			
产品特性	典型值		测试方法
颜色	灰色		目视
结构&成份	陶瓷填充硅橡胶		-
厚度范围 (inch/mm)	0.016~0.030 0.40~0.75	0.040~0.200 1.00~5.00	ASTM D374
硬度 (Shore OO)	10	10	ASTM D2240
密度 (g/cm ³)	3.5		ASTM D792
建议使用温度范围 (°C)	-40 ~ 200		-
击穿电压 (V/mm)	≥5500		ASTM D149
介电常数 @1MHz	6.7		ASTM D150
体积电阻率 (Ohm-cm)	> 1.0×10 ¹²		ASTM D257
导热系数 (W/m·K)	8.5		ASTM D5470
	8.5		ISO22007
阻燃等级	V-0		UL94 (E331100)

热阻抗



压缩率



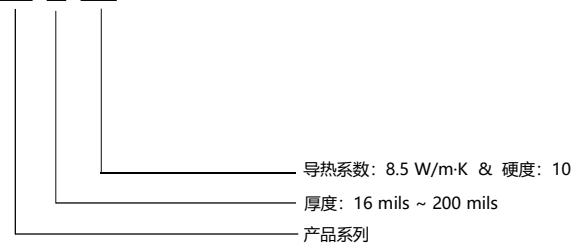
产品规格

标准厚度: 0.016" (0.40 mm) ~0.200" (5.00 mm) , 以 0.010" (0.25 mm) 为增量。
标准尺寸: 16"×16" (406 mm×406 mm)

TIF®系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

产品型号说明

TIF7 00 RES



全球方案：在地服务

中国: +86-769-38801208
 台湾: +886-2-2277-1007
 加拿大: +001-604-2998559
 越南: +84-396852859

service@ziitek.com

www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科科技有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。



TIF700RES-1025